

## 古河電気工業(株) 事業 IR 説明会 質疑応答録 (要旨)

日時：2020年11月24日(火) 13:00-13:45

内容：機能製品事業

説明者：執行役員常務 機能製品統括部門長 大野 良次

陪席者：AT・機能樹脂事業部門長 矢野 正三

サーマル・電子部品事業部門長 本村 拓也

メモリーディスク事業部門長 宮崎 秀彦

執行役員 銅箔事業部門長 柳 登志夫

機能製品統括部門企画統括部長 齊藤 孝史

取締役兼執行役員 財務・グローバルマネジメント本部長 福永 彰宏

Q：半導体製造用テープは、メモリ以外の用途に展開をしていくとのことだが技術面など新しい対応が必要になるのか？また、ターゲットとする顧客の地域は？

A：現在もいろいろな種類のテープを供給している。顧客の加工工程や固有の商品特性に合致したものを提供、顧客要望との合わせ込みが強みとなっている。業界のなかで力のある上位メーカーが顧客ターゲット。競合は日本、台湾、米系のメーカー。特に台湾勢は積極的、米系も出てきている。

Q：サーマル製品の市場環境や競合、御社の立ち位置は？

A：各社がターゲットとしている用途等により注力している発熱量特性が異なる（ため競合とは比較しづらい）。データセンタやCPUは300W程度で狭い範囲を冷却する。鉄道や太陽光関係は10kWレベルの冷却が必要であり、単体の金属製品では冷やしきれない。ヒートパイプまたはヒートパイプに変わる開発品を使用しないと冷やしきれない分野をターゲットとしている。

Q：半導体製造用テープは既存顧客における他社との競争激化などあると思うが、今後1~2年をどうみているか？

A：過去から申しあげているが競争環境は厳しい。当社が納入シェアトップの韓国メーカー向けは、MADE IN KOREAの方針により特に今年度は厳しい状況。当社の技術的優位性はあると思うが、さらに今後の競争環境は厳しくなるだろう。そのために積極的な拡販を行っていく。

Q：銅箔は足元が厳しいなか、高機能品へのシフトを進めていると思うが、どのぐらいの時間軸での改善を見込んでいるか？

A：市場環境の回復とともに改善するとみているが、(今年の)台湾拠点の火災影響は大きく、来年度に向けて立て直し中。現在、顧客へのスペックインを行っており、来年度は回復する見通し。

Q：火災で被害を受けた銅箔台湾拠点の製造能力は、どの程度まで回復させるのか？

A：火災前の製造能力水準まで戻すことは考えていない。高機能品の比率を向上させていく。

Q：半導体製造用テープは、なぜこれまでメモリ以外の用途展開を行ってこなかったのか？

A：業界最上位であり数量規模の多い顧客への納入で安定的に収益を確保する、というのが第一の方針。ただし数年前から他社や多用途への種まきも進めており、今後、より本格的に注力していくということ。

Q：上期は民間の建築工事の遅れより、機能製品に影響があったとのことだが今後の見通しは？また、スキルフリー製品での収益貢献見通しは？

A：今後の回復見通しについてはまだよく見えていないところはあるが、回復は来年度になる可能性あり。特に鉄道関係は回復時期が遅れている。スキルフリー製品は、工事遅れ＝職人不足に対するキャッチアップの要望に対し、積極的に拡販していく。市場環境が戻ったときに、当社製品がしっかりと顧客に認知されている、という状況を目指す。

Q：銅箔の今後の生産能力回復について定量的なイメージを教えてください。また、高機能製品の比率は？

A：（回路箔全体の）生産能力については、火災前に対して8割の水準を目指す。高機能製品比率は定量的に示すことはできないが、さらなる向上を目指す。また、注力している回路箔だけでなく、電池箔についても特長を評価してくださる顧客向けの供給を継続し、回路箔と電池箔の最適なバランス構成により収益向上を図っていく。

Q：5Gによる銅箔に対する変化、高周波対応による銅箔へのインパクトは？

A：銅箔に限らず5G対応では高速/高機能が求められる。開発の方向性自体に大きな変化はないが、高速という要望に対応した開発を促進していく。銅箔表面の平坦性と樹脂等との密着性の両方のバランスをふまえた箔の開発を進めている。

以上